

2021-2026年中国射频芯片市场竞争格局及投资战略规划报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国射频芯片市场竞争格局及投资战略规划报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/electric/707512.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

射频前端芯片负责频率合成、功率放大、信号在不同频率下的收发，包括射频功率放大器（PA）、射频低噪声放大器（LNA）、射频开关、滤波器、双工器等。目前射频前端芯片主要应用于手机和通讯模块市场、WiFi路由器市场和通讯基站市场等。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：射频芯片行业定义及产业链分析

1.1射频芯片定义及产品分类

1.1.1射频芯片定义

1.1.2射频芯片产品分类及主要功能

1.1.3射频模组及集成度

1.2射频芯片产业链结构图

1.3射频芯片产业链上游市场分析

1.3.1砷化镓（GaAs）半导体材料市场分析

（1）材料概述

（2）下游应用

（3）市场规模

（4）企业格局

（5）需求趋势

1.3.2碳化硅（SiC）半导体材料市场分析

（1）材料概述

（2）下游应用

（3）市场规模

（4）企业格局

（5）需求趋势

1.3.3氮化镓（GaN）半导体材料市场分析

（1）材料概述

（2）下游应用

（3）市场规模

（4）企业格局

（5）需求趋势

1.4射频芯片产业链下游市场分析

1.4.1全球智能手机市场发展分析

1.4.2中国智能手机市场发展分析

第2章：中国射频芯片行业发展宏观环境分析

2.1射频芯片行业发展政策环境分析

2.1.1行业监管体系及职能

2.1.2行业政策规范汇总

2.1.3行业重点规划解读

2.1.4行业政策环境影响分析

2.2射频芯片行业发展经济环境分析

2.2.1全球经济发展现状分析

2.2.2主要国家经济发展现状

2.2.3中国经济发展现状分析

2.2.4全球主要经济体经济展望

2.2.5行业经济环境影响分析

2.3射频芯片行业发展技术环境分析

2.3.1 G技术对射频芯片行业发展影响分析

2.3.2射频芯片行业专利申请情况

2.3.3行业企业技术研发投入情况

2.3.4行业最新研发动态

2.3.5行业技术环境影响分析

2.4射频芯片行业发展贸易环境分析

2.4.1中美国际形式梳理及最新进展

2.4.2国际形式对于射频芯片行业发展影响分析

2.5疫情影响射频芯片行业发展机遇与挑战

第3章：全球及中国射频芯片行业发展现状分析

3.1全球及中国射频芯片行业发展特点分析

3.1.1行业市场集中度高

3.1.2射频器件模组化趋势明显

3.1.3国内企业多聚焦分立器件市场

3.1.4部分产品国产替代进行时

3.2全球及中国射频芯片行业市场规模分析

3.2.1全球射频芯片行业市场规模现状

3.2.2中国射频芯片行业市场规模现状

3.3全球及中国射频芯片行业竞争格局分析

3.3.1全球总体企业格局

3.3.2全球总体细分产品格局

3.3.3国内企业射频芯片业务布局

第4章：全球及中国射频芯片行业细分产品市场分析

4.1滤波器市场分析

4.1.1滤波器产品简介

4.1.2滤波器市场规模分析

4.1.3滤波器市场竞争格局

4.1.4滤波器需求前景预测

4.2功率放大器（PA）市场分析

4.2.1功率放大器（PA）产品简介

4.2.2功率放大器（PA）市场规模分析

4.2.3功率放大器（PA）市场竞争格局

4.2.4功率放大器（PA）需求前景预测

4.3射频开关市场分析

4.3.1射频开关产品简介

4.3.2射频开关市场规模分析

4.3.3射频开关市场竞争格局

4.3.4射频开关需求前景预测

4.4低噪放（LNA）市场分析

4.4.1低噪放（LNA）产品简介

4.4.2低噪放（LNA）市场规模分析

4.4.3低噪放（LNA）市场竞争格局

4.4.4低噪放（LNA）需求前景预测

4.5射频模组市场分析

4.5.1射频器件模组化优势分析

4.5.2射频模组市场规模分析

4.5.3射频模组市场竞争格局

4.5.4射频模组需求前景预测

第5章：全球及中国射频芯片行业投资兼并购及重组分析

5.1行业投资兼并购及重组特点分析

5.2行业投资兼并购及重组动因分析

5.3行业投资兼并购及重组规模分析

5.4行业投资兼并购及重组趋势展望

第6章：全球及中国射频芯片行业重点企业分析

6.1国际重点企业分析

6.1.1 Skyworks

- (1) 企业简介
- (2) 企业发展历程
- (3) 企业射频芯片产品布局
- (4) 企业经营业绩情况
- (5) 企业核心客户

6.1.2 Qorvo

- (1) 企业简介
- (2) 企业发展历程
- (3) 企业射频芯片产品布局
- (4) 企业经营业绩情况
- (5) 企业核心客户

6.1.3 Avago

- (1) 企业简介
- (2) 企业发展历程
- (3) 企业射频芯片产品布局
- (4) 企业经营业绩情况
- (5) 企业核心客户

6.1.4 Murata

- (1) 企业简介
- (2) 企业发展历程
- (3) 企业射频芯片产品布局
- (4) 企业经营业绩情况
- (5) 企业核心客户

6.1.5 Qualcomm

- (1) 企业简介
- (2) 企业发展历程
- (3) 企业射频芯片产品布局
- (4) 企业经营业绩情况
- (5) 企业核心客户

6.2国内重点企业分析

6.2.1江苏卓胜微电子股份有限公司

- (1) 企业基本信息
- (2) 企业主营业务分析

(3) 企业射频芯片产品布局

6.2.2 上海韦尔半导体股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业主营业务分析

(3) 企业射频芯片产品布局

6.2.3 深圳市信维通信股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业主营业务分析

(3) 企业射频芯片产品布局

6.2.4 昂瑞微电子技术有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业主营业务分析

(3) 企业射频芯片产品布局

6.2.5 安光电股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业主营业务分析

(3) 企业射频芯片产品布局

6.2.6 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业主营业务分析

(3) 企业射频芯片产品布局

6.2.7 深圳紫光展锐科技有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业主营业务分析

(3) 企业射频芯片产品布局

6.2.8 深圳顺络电子股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业主营业务分析

(3) 企业射频芯片产品布局

第7章：中国射频芯片行业投资前景及策略建议

7.1 中国射频芯片行业发展前景展望(AK HT)

7.1.1 行业发展影响因素分析

(1) 有利因素

(2) 不利因素

7.1.2 行业发展趋势分析

7.1.3行业发展前景预测

7.2中国射频芯片行业投资壁垒分析

7.2.1资金壁垒

7.2.2技术壁垒

7.2.3客户壁垒

7.3中国射频芯片行业投资风险分析

7.3.1 G技术应用不及预期

7.3.2产品研发不及预期

7.3.3客户拓展不及预期

7.4中国射频芯片行业投资机会分析

7.4.1 G落地带来的投资机会

7.4.2中美国际形式带来的市场机会

7.4.3顶层政策出台带来的发展机会

7.5中国射频芯片行业投资建议

图表目录：

图表1：射频芯片

图表2：射频芯片产品分类

图表3：射频模组及集成度分类

图表4：砷化镓下游应用

图表5：砷化镓企业格局

图表6：碳化硅下游应用

图表7：碳化硅企业格局

图表8：氮化镓下游应用

图表9：氮化镓企业格局

图表10：全球智能手机出货量

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/electric/707512.html>